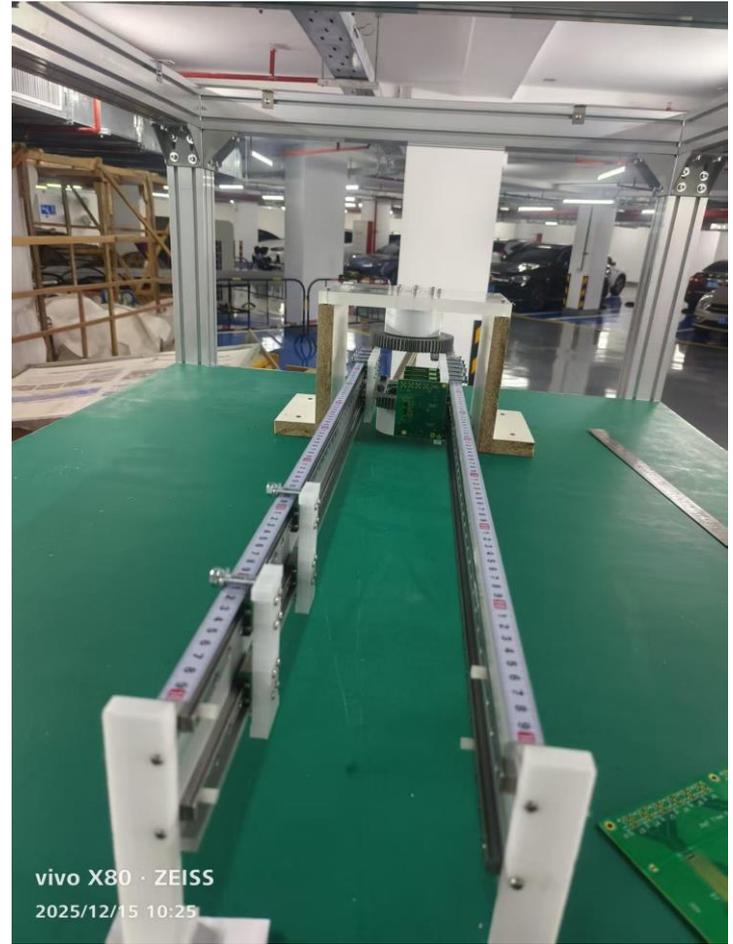
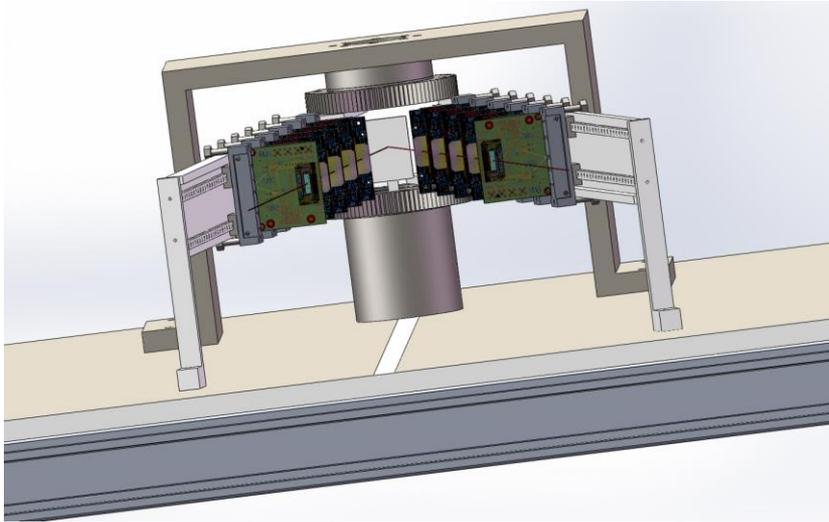
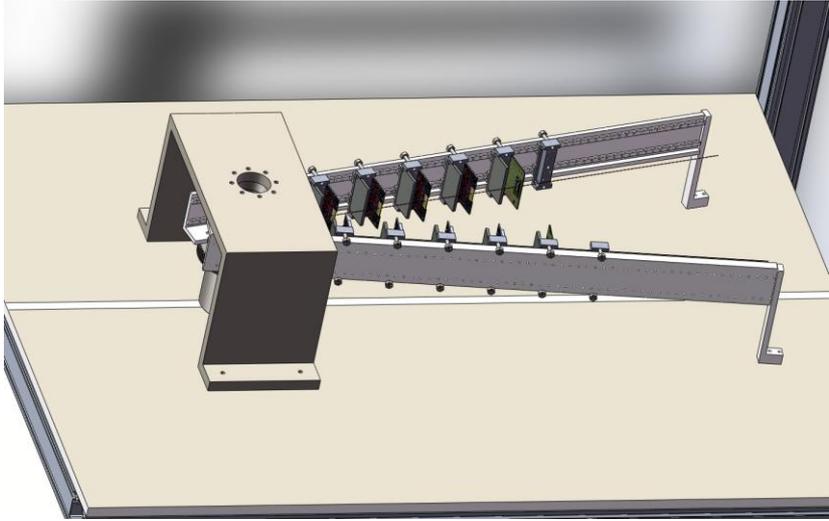
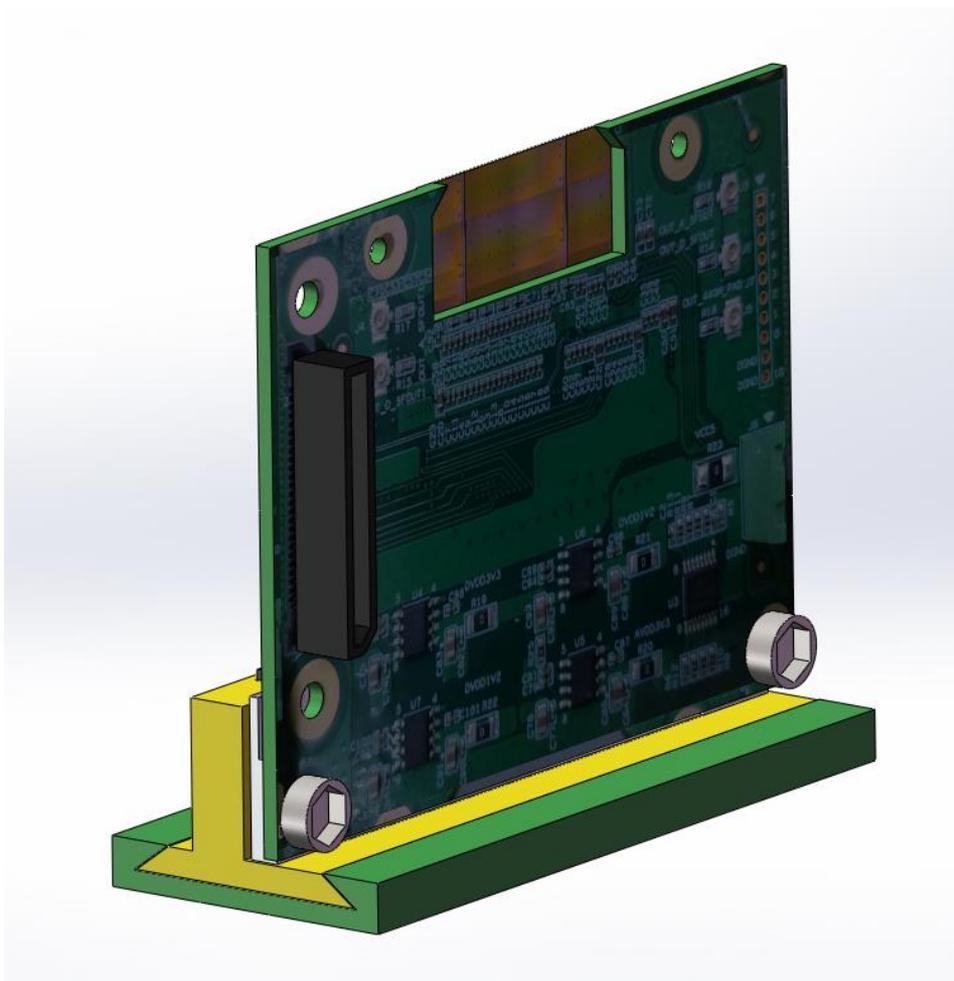


H-NSO机械结构



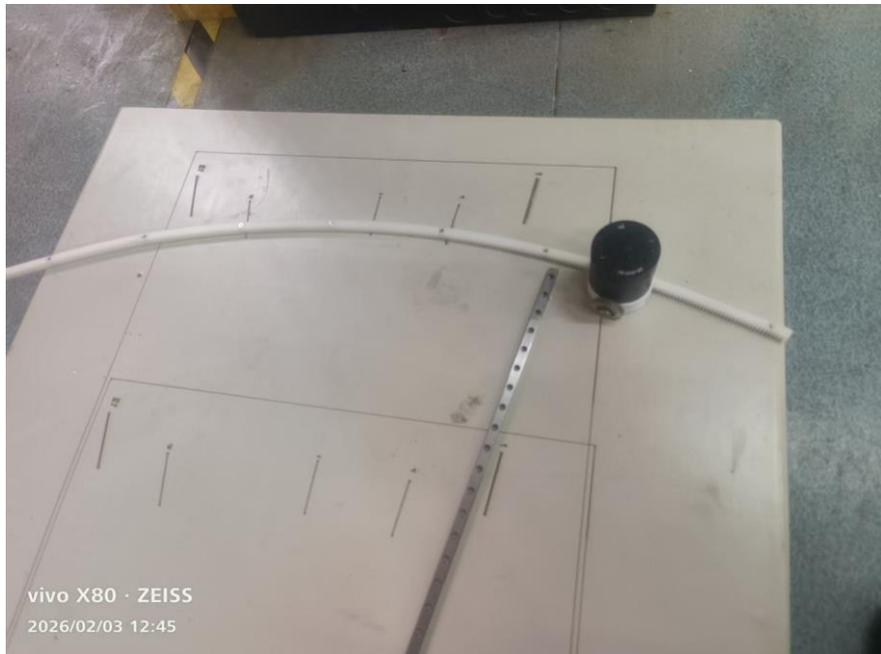
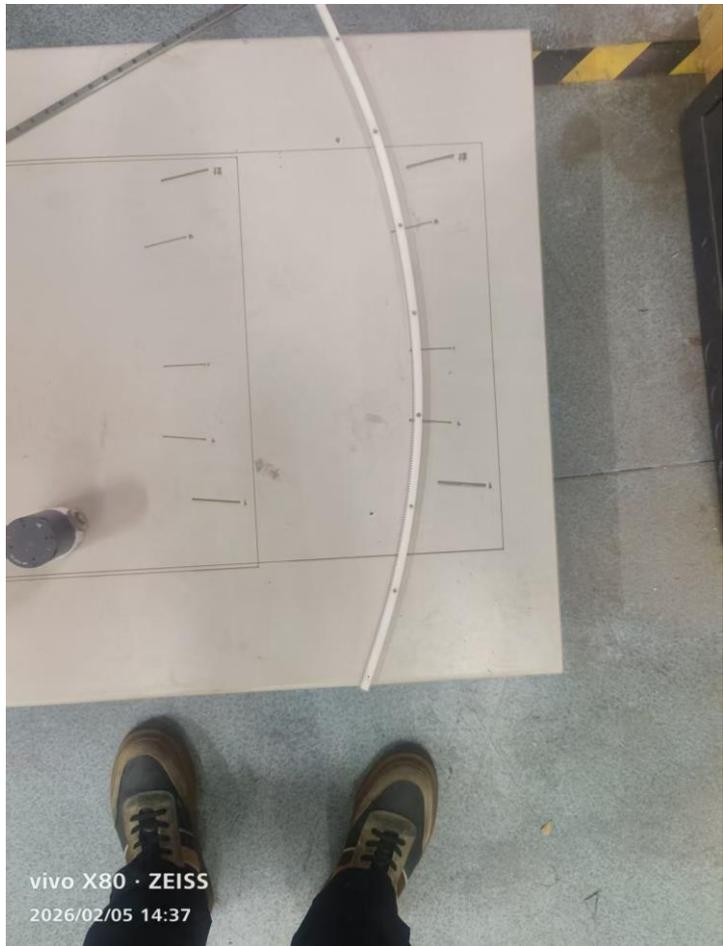
载板夹具需细化



DM电机齿轮结构

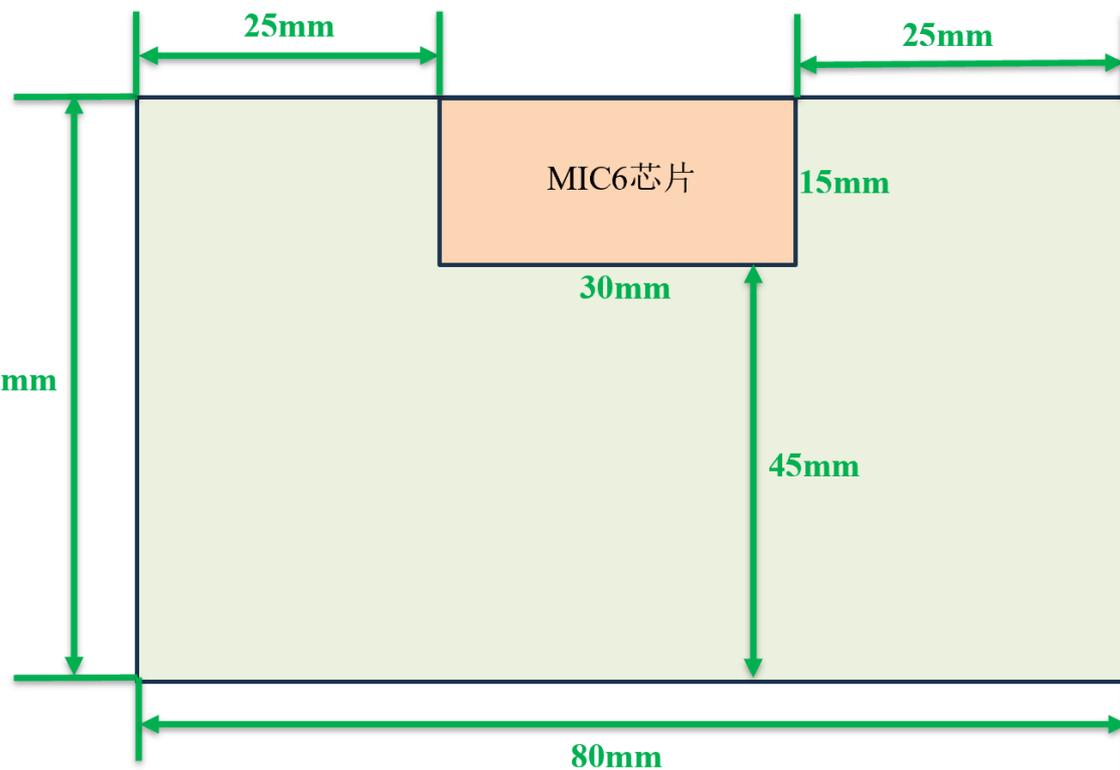


圆弧轨道与电机组组合



MIC6芯片载板

- MIC6载板尺寸80mm x 60mm
- MIC6芯片尺寸30mm x 15mm，芯片贴着板子上边缘放置，位于板子中间



MIC6芯片载板（顶层）



MIC6芯片载板（底层）

MIC6芯片测试

测试进展:

- 通过RU板完成MIC6-V3芯片的SPI读写配置
- 通过RU板完成MIC6-V3芯片的像素配置
- 完成MIC6-V3芯片并行读出测试和串行读出测试

存在问题:

- MIC6-V3芯片PLL供电引脚需1.2V，实际接成3.3V（芯片设计文档错误，[通过修改打线进行测试](#)）
- 转接板时钟扇出芯片驱动能力不够，MIC6-V3芯片PLL输入时钟不正常（[通过外部时钟板接入PLL输入时钟](#)）
- MIC6-V3芯片串行数据速率较低，不能接FPGA的高速串行接口，只能接普通IO口

连接线
MIC6芯片载板
转接板
RU板



MIC6-V3测试系统

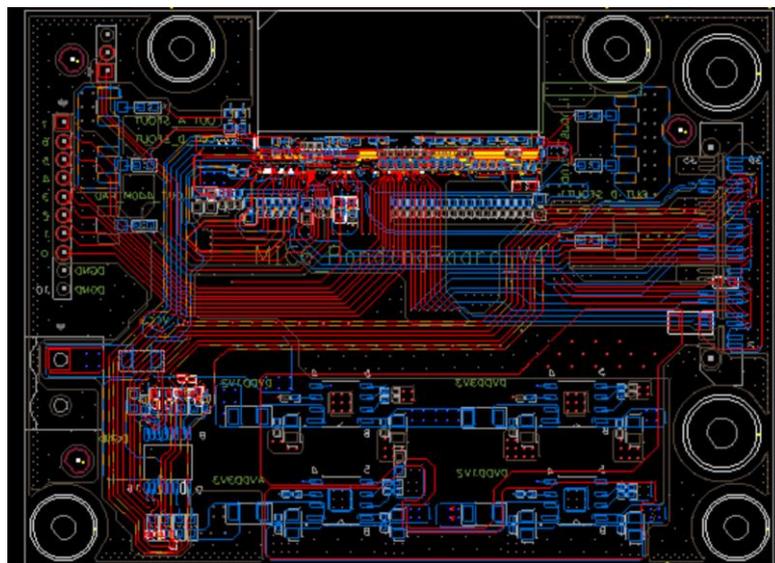
进展及计划安排

MIC6载板（华师）：

- 已完成新MIC6-V3芯片载板原理图和PCB设计
- 计划年前完成MIC6-V3载板的加工，2月底完成贴片
- 计划3月初开始新MIC6-V3载板和新转接板的测试

转接板（科大）：

- 已完成转接板原理图和PCB设计
- 已完成转接板的加工和贴片
- 新转接板结合第一版的载板进行测试



新MIC6载板



束流测试计划

- 基于MIC6-V3开展束流测试，验证链路可行性：3月份可就位
- MIC6-V4芯片将于5月份完成流片，需1~2个月的芯片表征测试，模块组装与测试需1~2周；然后开展束流测试，验证物理取数：估计7月份可就位